

Question de Mme Kattrin Jadin à la Vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances, sur " Les cartes d'identité électroniques "

Kattrin Jadin (MR):

Je souhaiterais faire le point avec vous sur les nouvelles cartes d'identité électroniques dont la puce électronique semble protéger les données personnelles de manière optimale. S'il est vrai qu'avec ce nouveau système d'identification, la Belgique répond à l'importance de la communication électronique de notre époque, la production des eID pose problème. Depuis 2005, 183.285 cartes d'identité (dont 47.000 en 2009) ont dû être jetées parce que la puce électronique s'était détachée. Ceci a coûté plus que deux millions d'euros à l'entreprise Zetes Card qui produit ces cartes. Et le problème n'a toujours pas été solutionné: encore l'année passée, 22.500 cartes ont dû être jetées. 1. Confirmez-vous ces chiffres? 2. Va-t-on améliorer le système de production des puces électroniques en question afin d'éviter dans le futur ces inconvénients et coûts inutiles?

Joëlle Milquet, ministre:

1. Au 30 juillet 2013, les chiffres suivants sont enregistrés pour 'puces décollées':[GRAPH: 2012201313850-6-1066-fr] Il s'agit des cas de 'puces décollées' qui ont été enregistrés et pour lesquels un défaut de fabrication a été constaté. Ces frais sont à charge du fabricant de la carte. 2. Des projets sont aujourd'hui en cours d'élaboration en vue de l'utilisation d'un nouveau module pour la puce des cartes d'identité électroniques. Un nouveau module actuellement développé par le fabricant de puces doit permettre une bien meilleure adhésion de la puce sur la carte. Les tests de qualité préalablement effectués sont prometteurs. Tous les tests sont finalisés depuis juin 2013. En fonction de l'évaluation des résultats des tests, le Registre national décidera, au cours du troisième trimestre de 2013, de la mise en oeuvre ou non de ce nouveau module. C'est seulement ensuite qu'une phase-pilote sera entamée (prévue pour le quatrième trimestre de 2013). L'utilisation généralisée de ce module 'molded' est prévue pour début 2014, à condition que la phase-pilote fasse l'objet d'une évaluation positive. Outre le développement d'un nouveau module, d'importants efforts sont consentis par le fabricant de cartes pour limiter le décollement de la puce. Dans l'actuel processus de fabrication des cartes, des tests de qualité pour 'puces décollées' sont effectués conformément à la norme ISO24789. Un audit externe de ces contrôles a confirmé la qualité des tests.